

行政院及所屬機關出國報告

(出國類別：會議)

參加國際電子零組件品質評估制度(IECQ)

2010 年會報告

出國人服務機關：經濟部標準檢驗局

職稱姓名：陳局長介山

王組長石城

派赴國家：美國

出國日期：99 年 4 月 12 日至 99 年 4 月 17 日

報告日期：99 年 7 月 17 日

摘要

「電子零組件品質評估制度」(IEC Quality Assessment System for Electronic Components, 簡稱 IECQ), 乃是國際間對於電子零組件品質評估及驗證的機制, 凡 IECQ 會員國之電子零組件產品, 均可以自由銷售於其他會員國之間並免於受重複之進口檢驗。IECQ 範圍涵蓋各類電子零組件的製造工廠、經銷商、獨立實驗室、專業承包商, 近年並擴及航太領域及環保概念的有害物質製程管理(HSPM), 認可項目包括品質認可、能力認可、技術認可及製程認可, 提升電子零組件的品質, 及推動國際間對於電子零組件品質及管理, 致力於透過 IECQ 電子零組件品質要求的一致性, 促進有關電子零組件的國際貿易。近年來, 我國雖已進入電子資訊大國之列, 然而我國為外銷導向的國家, 面對國際市場之激烈競爭與世界經濟局勢之瞬息萬變, 我國電子業除不斷提昇產品層次與品質外, 參加國際性品質認證制度, 也是突破貿易障礙, 拓展國際市場之行銷途徑之一。

因為國際現實因素, 我國參與 IECQ 制度係透過美國 IECQ 制度的國家管理機構 (National Authorized Institution, NAI) ECCB (The Electronic Components certification Board, Inc.), 藉此次參與會議機會與美國 ECCB 舉行閉門會議, 討論我國未來推動 IECQ 制度的規畫, 獲致以下結論:

- 美國 ECCB/ECCC 持續支持我國 CTECCB 開發新的認證計畫, 以符合我國產業界之需要。
- 美國 ECCB 同意邀請本局指派航太專家擔任 Subject Matter Expert(SME), 發展台灣之航太電子認證。
- IECQ 相關技術委員會及工作小組 SC 01(市場開發)、WG 4(航太電子)、WG 6 (HSPM 產品認證)等, 將請本局指派專家參與小組會議。
- 以往美國 ECCB 與我國 CTECCB 所簽訂之各項合約繼續有效。

我國參與國際電子零組件品質評估制度 IECQ, 雖然過程有所曲折, 就實質而言, 已經達成相當的效益, 能夠在 IECQ 制度的推動過程中積極反映我國產業界的需求, 積極做出貢獻, 並獲得國際間的肯定與重視。此次 IECQ 年度會議中, CAG 會議主席特別邀請我方代表專題演講, 介紹我國電機電子發展及未來的展望, 在 IECQ 國際場合展現我國經濟發展的成果, 同時做好國民外交。在此次行程與美國 ECCB 會議之中, ECCB 主席鼓勵我方多派遣專家參與 IECQ 組織相關工作小組之會議, 當其他國家代表了解台

灣對 IECQ 組織之貢獻之後，台灣參與其他組織也會比較容易。顯見堅強的經濟發展實力及積極的工作態度，為參與相關國際組織活動，爭取我國最大權益的有利後盾。

鑑於電子零組件及產品在汽車中使用之比例愈來愈高，汽車電子產業為我國現階段積極推動發展之產業項目。在此次會議中規劃汽車電子認證之工作小組(WG 8)雖沒有提出具體的認證計畫，但亦提出系統、製程及產品之三階段認證計畫之概念，如何落實為文件化之認證標準及實際認證作業，需要繼續與國內廠商、汽車業者作深入的討論，更需專家的參與才能定案。積極參與 IECQ 制度，可以發揮我國產業創新研發的優勢，透過認證標準初期發展階段的實際參與，可以最大程度進行適合我國產業發展需求的規畫，提升我國相關產業的國際競爭力及市場商機。

報告目次

壹、緣起及目的.....	p.1
一、IECQ 簡介.....	p.1
二、我國推動參與 IECQ 制度.....	p.1
三、出席會議目的.....	p.5
貳、出國行程.....	p.6
一、出國人員.....	p.6
二、出國行程及工作內容.....	p.6
參、會議紀要.....	p.6
一、CAG 會議.....	p.6
二、與美國 ECCB 會議.....	p.7
三、CBAC 會議.....	p.9
四、MC 會議.....	p.11
肆、綜合結論與建議.....	p.15
一、綜合結論.....	p.15
二、心得與建議.....	p.15
伍、活動照片.....	p.17
陸、附件.....	p.19

壹、緣起及目的

一、IECQ 簡介

國際電工技術委員會(The International Electro-technical Commission, 簡稱 IEC)是世界上最早的國際標準化機構，成立於 1906 年，負責有關電機及電子領域國際標準的制定工作。為了推廣 IEC 國際標準，增進電子零組件的品質，並促進電子零組件國際貿易之便捷化，IEC 組織於 1979 年因美國、日本之促請而成立了「電子零組件品質評估制度」(IEC Quality Assessment System for Electronic Components, 簡稱 IECQ)，作為國際間對於電子零組件品質評估及驗證的機制，凡 IECQ 會員國之電子零組件產品，均可以自由銷售於其他會員國之間並免於受重複之進口檢驗。IECQ 範圍涵蓋各類電子零組件的製造工廠、經銷商、獨立實驗室、專業承包商，近年並擴及航太領域及環保概念的有害物質製程管理(HSPM)，認可項目包括品質認可、能力認可、技術認可及製程認可，提升電子零組件的品質，及推動國際間對於電子零組件品質及管理，致力於透過 IECQ 電子零組件品質要求的一致性，促進有關電子零組件的國際貿易 (IEC/IECQ 之組織架構圖如圖 1)。

IECQ 組織每年舉辦一次管理委員會(Management Committee, MC)及檢查機構一致性評估委員會 (Conformity Assessment Bodies Committee, CABC)會議，會議地點由瑞士日內瓦的 IECQ 總部及各會員國輪流主辦。2010 年輪由美國舉辦，會議期間為 2010 年 4 月 12 日至 16 日，會議地點在美國華盛頓州史迪文生市 Skamania Lodge 舉行。與此次 IECQ 年會併同舉行之業務發展(Business Development, BD)會議於 4 月 12 日舉行，主席諮詢會議(Chairman Advisory Group, CAG)於 4 月 13 日舉行，CABC 會議於 4 月 14 日舉行，MC 會議於 4 月 15 日舉行，工作小組(Working Group, WG) 4,5,6,7 會議則分別於 4 月 13 至 16 日舉行。

二、我國推動參與 IECQ 制度

近年來，我國雖已進入電子資訊大國之列，然而我國為外銷導向的國家，面對國際市場之激烈競爭與世界經濟局勢之瞬息萬變，我國電子業除不斷提昇產品層次與品質外，參加國際性品質認證制度，也是突破貿易障礙，拓展國際市場之行銷途徑之一。因此，經濟部工業局於民國 69 年開始籌劃加入 IECQ 制度，並於 72 年成立我國的電子零件認證委員會(CTECCB)，負責國內 IECQ 制度推廣，透過美國 IECQ 制度的國家管理

機構(National Authorized Institution, NAI) ECCB (The Electronic Components certification Board, Inc.) 參與 IECQ 組織的活動。

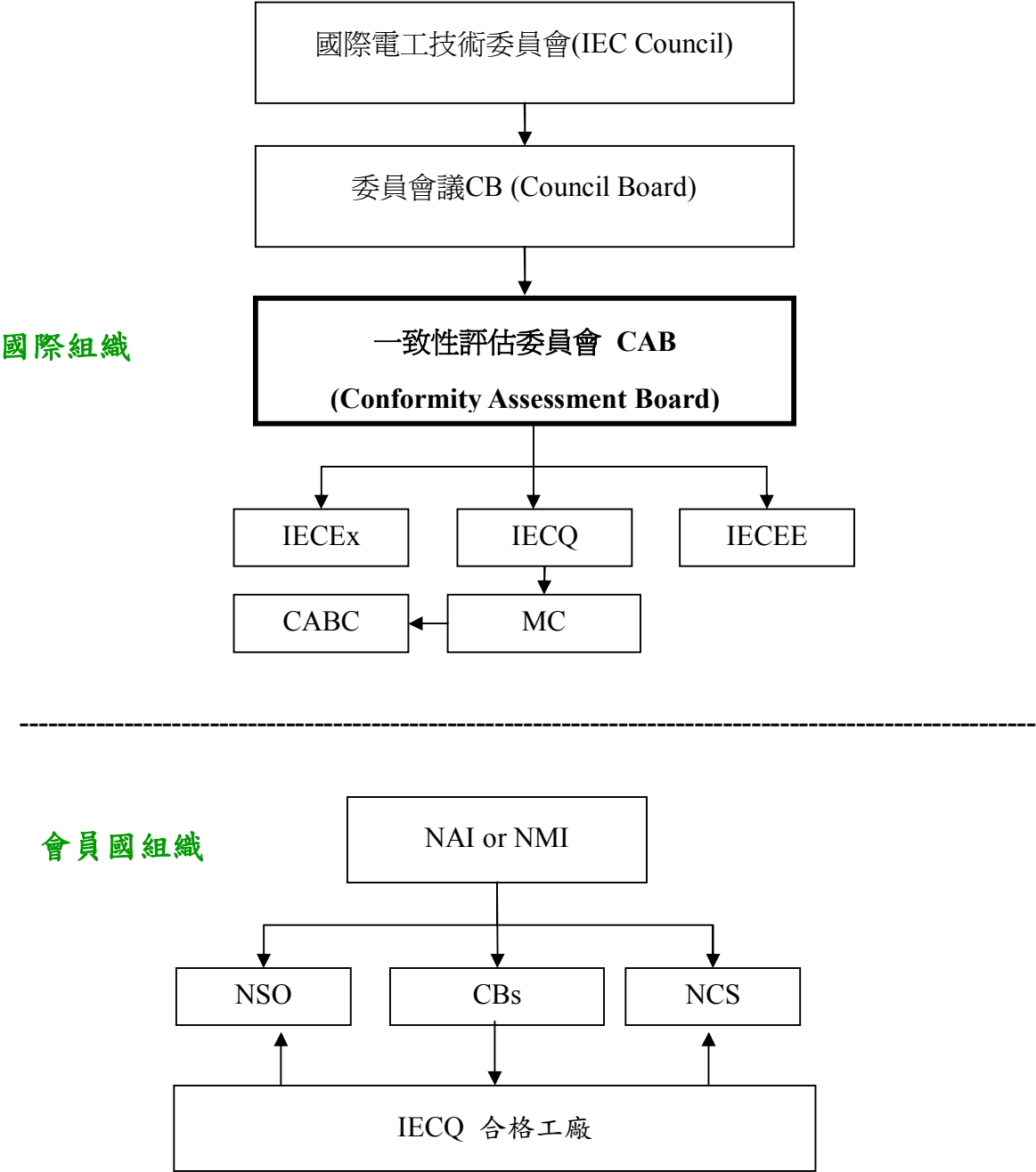


圖 1 IEC/IECQ 之組織架構圖

根據國際電工技術委員會 (IEC) 基本規章之要求，每一會員國在加入組織之後，必須成立一個國家最高行政機構，這個行政機構的名稱在會員國稱為國家授權機構 (NAI)，我國因非聯合國會員國，所以是以觀察員的名義加入 IECQ 組織，因而根據 IECQ

規章所成立之國家最高行政機構稱為 NMI (National Management Institution)。依規章之規定，NMI 有權參加 IECQ 的年度會議，但沒有發言權與投票權，其國內 IECQ 制度之運作與國際 IECQ 制度之參與必須透過會員國之 NAI 行使，我國參加 IECQ 組織所成立之國家最高行政機構為中華民國電子零件認證委員會(CTECCB)，當我國於民國 72 年加入 IECQ 組織時，即與美國電子零件認證委員會(ECCB)簽約，成為美國電子零件認證委員會之會員，架構在美國國家授權機構(NAI) ECCB 的組織之下運作 IECQ 制度。

此項制度推展至今，已有百餘家廠商取得組織及產品認可，並登錄於 IECQ 之網站名錄中，對於廠商及國家之品質提升與形象助益均有幫助。我國 IECQ 運作計畫自 72 年起執行迄 98 年計 26 年，工業局考量該計畫屬性為標準、檢驗及認證業務，爰依業務分工調整執行機關，經奉核定自 99 年 1 月起計畫轉移至本局執行。

中華民國 IECQ 制度國家管理機構運作計畫內容包括：

1. IECQ 制度國家管理及工廠評估之工作

- (1) 各項認證項目之申請及維持管理。
- (2) 協助新廠家首次認證稽核。
- (3) 與稽核單位、工廠之協調及稽核評估工作。

2. 國際認證制度、標準及最新技術資訊之蒐集及掌握

- (1) 與IECQ參加國及總部聯繫事務並及參加IECQ年會會議。
- (2) 與美國ECCB聯繫事務及參加其年會。
- (3) 蒐集國際技術標準資料並提供我國IECQ資訊予國外，配合IECQ組織國際間之宣廣活動。

3. 國際品質認證制度之推廣

- (1) 工廠推廣及技術諮詢服務。
- (2) 參加電子展及舉辦研討會。
- (3) 發行刊物、文宣、電子報及網站維護。

我國參加 IECQ 制度之架構如圖 2。

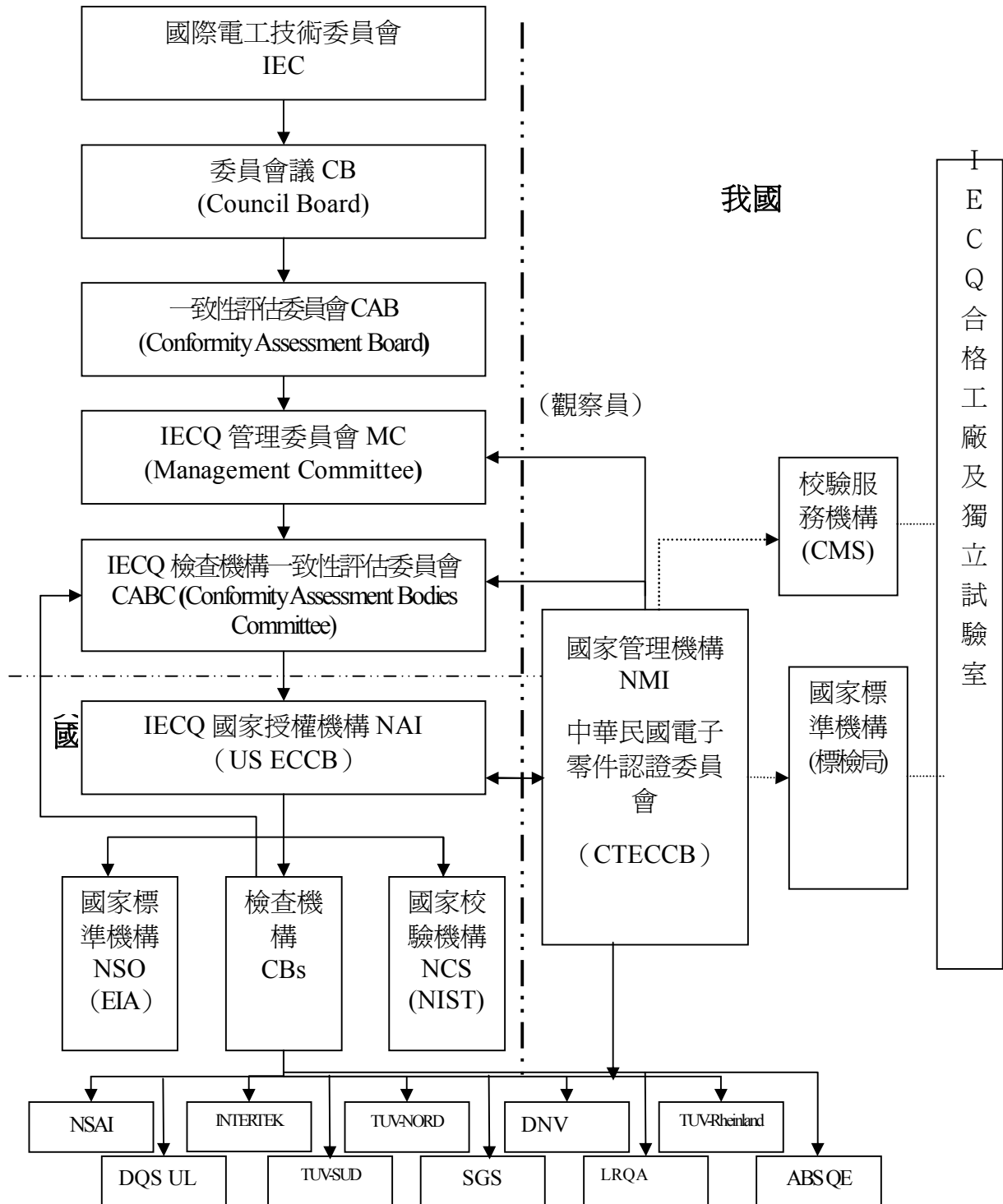


圖 2 目前我國參加 IECQ 制度之架構

三、出席會議目的

2010 年 IECQ 組織年會是由美國 NAI 舉辦，會議期間由 2010 年 4 月 12 日至 16 日，會議地點在美國華盛頓州史迪文生市 Skamania Lodge。鑑於今(99)年為本局接辦我國 IECQ 制度國家管理機構運作計畫的第一年，IECQ MC 主席特別邀請本局局長與會（邀請函以 IECQ 秘書處秘書 Mr. Chris Agius 具名於 2010/1/21 發出，如附件 1），以瞭解 IECQ 制度在我國運作的情形及本局未來推動的方向，因此本局由陳局長介山率業務組王副組長石城(時任副組長)參與 13 日至 15 日的 MC 及 CABC 會議，並藉此機會與美國 ECCB 舉行閉門會議，說明我國推動 IECQ 制度情形，深入討論未來如何繼續加強推動 IECQ 制度的規畫，檢討未來美國 ECCB 與我國 CTECCB 繼續合作需要互相支援的事項。

我國 IECQ 制度國家管理機構運作計畫，係以中華民國電子零件認證委員會 (CTECCB) 推動，依 IECQ 組織規章，CTECCB 雖為觀察員，仍有資格參加 WG、IECQ CABC 及 IECQ MC 會議，歷年來也對 IECQ 制度的推展做出許多貢獻。為維護我國參加 IECQ 制度應有的權利、了解國際電工技術委員會電子零組件品質評估制度之各會員國推行 IECQ 制度的現況、發表我國推行 IECQ 制度的成果、表達我國業界對 IECQ 制度的建議、取得 IECQ 制度最新的動態及與各會員國進行聯誼活動，由該會鄭主任委員富雄（鄭主任委員同時為我國電機電子工業同業公會副理事長）率李執行秘書書和代表全程出席 12 日至 16 日的會議。會中我國代表出席人員並接受主席邀請參加 CAG (Chairman's Advisory Group) 會議，由鄭主任委員富雄先生擔任一小時之專題演講人，對 CAG 會議出席人員報告我國電機電子工業同業公會組織、會員架構及 IECQ 制度在台灣發展之現狀及未來的展望。為使未來 IECQ 制度未來推動方向能符合我國業界需要，CTECCB 出席會議代表除參加 IECQ 之 MC 及 CABC 會議外，亦參與所有 WG (Working Group) 會議，並在 WG 會議中報告汽車電子認證計畫之架構、規劃及進度。

貳、出國行程

一、出國人員：

經濟部標準檢驗局 陳局長介山
經濟部標準檢驗局 王副組長石城

二、出國行程及工作內容：

日期	工作內容
4月12日	搭機經美國洛杉磯市、奧勒岡州波特蘭市後搭車轉赴華盛頓州史迪文生市
4月13日	CAG 會議：TEEMA 專題報告 與 ECCB 閉門會議
4月14日	IECQ 檢查機構一致性評估委員會(CABC)會議
4月15日	IECQ 管理委員會(MC)會議
4月16日至 17日	至波特蘭市機場搭機，經洛杉磯返台

參、會議紀要

一、CAG 會議

出席人員：Mr. David Smith (MC Chairman), Mr. Chris Agius (IECQ CO), Mr. Wang J. Y. (CEPREI), Mr. Stan Salot (ECCB), Mr. Wynn Bowman (SC01), Mr. Chris Yau (CABC Vice Chairman), Mr. Joe Chapman (ECCB), Mr. J. Y. Liu (CNCA), Dr. Dreger (VDE), Mr. Michel Brenon (LCIE), Mr. Fujisawa(IEC Vice President, CAB Chairman)、經濟部標準檢驗局陳局長介山、王副組長石城、CTECCB 鄭主委富雄、李執行秘書書和。

CAG 會議係由 IECQ 正式會員代表參加，鑑於我國參與 IECQ 制度以來，對 IECQ 制度推動具有相當重要之貢獻，又我國電機電子產業的發展受到國際上相關的重視，主席 Mr. David Smith 特別邀請我國 CTECCB 鄭主任委員富雄（同時為電機電子工業同業公會副理事長）於中午時間做專題演講，對 CAG 會議出席人員介紹我國電機電子工業同業公會(TEEMA)組織架構、成員及推廣 IECQ 制度現狀及未來的展望，與會人員對我國電機電子產業的蓬勃發展與成就印象深刻。

CTECCB 鄭主任委員報告內容包括：

1. TEEMA 成員架構。
2. 台灣與中國大陸之關係，TEEMA 的角色扮演。
3. 為什麼要推動汽車電子、電機零件與產品認證計畫？
4. 台灣與中國大陸未來合作之願景。
5. 李執行秘書書和介紹規劃中之汽車電子認證計畫草案。
6. 要求會員、CB 及專家協助草擬第二階段之製程認證計畫草案。
7. 台灣目前認證狀況及維持持續成長之建議。

二、與美國 ECCB 會議

出席人員：經濟部標準檢驗局陳局長介山、王副組長石城、CTECCB 鄭主委富雄、李執行秘書書和、美國 ECCB 主席 Mr. Lloyd Condra、ECCB 秘書 Mr. Joe Chapman、ECCC 總裁 Mr. Stan Salot、IECQ/ICC 前任主席 Mr. Jack Isken、IECQ BD 工作小組 SC 01 召集人 Mr. Wynn Bowman。

會議由美方主席介紹出席會議之 ECCB 及相關人員之後，本局亦介紹我方代表出席人員，並感謝 ECCB 安排此次的會議，同時表示 IECQ 制度之推動，將有助於相關產業之繁榮發展。我國將持續支持並積極參與 IECQ 相關計畫，本局剛接辦我國 IECQ 制度國家管理機構運作計畫，將全力支持 CTECCB 推動 IECQ 業務，並鼓勵台灣業界採用 IECQ 制度。會中並由本局就我國 2010 年至 2011 年 IECQ 推動計畫、如何鼓勵台灣工廠申請 IECQ 各項認證計畫、美國 ECCB/ECCC（基於業務考量由 ECCB 主要成員組成公司型態之 ECCC）如何支持我國 CTECCB 業務推展，及是否與 ECCB 重新簽定 MOU 等問題提出簡報並詳細討論，簡報資料如附件 2，會議記錄詳如附件 3。

1. 2010 年至 2011 年在 CTECCB 轉換期間，標檢局之 IECQ 相關計畫為何

本局表示 2010 年是 CTCCB 業務委辦單位由工業局轉移至本局的第一年，有關 CTECCB 推動 IECQ 制度方面，將持續往年之所有作業繼續運作，維持負擔款及參加電子展等相關活動，同時尋求 CTECCB 參加 IECQ 組織提昇參與位階之機會。

2. 本局如何鼓勵台灣工廠申請 IECQ 各項認證計畫

本局表示我國工業局之業務在制定產業發展政策及推動產業發展，本局業務則為制定國家標準及產品檢驗法規，產品範圍包括 IT 設備、家用產品、電子及電機

等消費性產品，並詳細介紹本局主管業務包括制定及推行國家標準、度量衡法規及制度、商品檢驗法規及制度、消費品安全、管理系統驗證業務及認驗證體系的推動等。有關推動 IECQ 制度方面，將採行措施包括

- (1) 在 BSMI 網站上宣廣 IECQ 制度；
- (2) 持續維持負擔款，鼓勵工廠申請 IECQ 制度；
- (3) 針對 IECQ 合格工廠，研究簡化由 BSMI 所規範之檢驗制度的相關測試及工廠檢查要求；
- (4) 鼓勵未來我國認證機構全國認證基金會(TAF)與 IECQ 的合作，減少重複評鑑並降低相關認證作業之成本。

3. ECCB/ECCC 如何支持 BSMI/CTECCB 業務推展

我方提出意見，建議開發新的認證計畫，如 HSPM PA, REACH, ErP, Carbon Footprint, Automotive Approval Program 等，以符合產業界的需求、推動及開發市場對 IECQ 制度之需求、協助 CTECCB 提升在 IECQ 之位階、及擴大台灣參與其他國際電機電子產品相關驗證制度，如 IECEE CB Scheme。美方同意開發新的認證計畫中將增加 ECMP (Electronic Component Management Plan) /ECMP 軌道系統及汽車電子，並同意邀請本局指派航太專家擔任 Subject Matter Expert(SME)，發展台灣之航太電子認證。至於協助我方參與國際組織方面，則 ECCB 本身尚難使力，有賴未來國際局勢的變更。本局進一步說明目前 IECEE CB Scheme 業務在台灣方面的進展，仍希望美方在適當時機可以積極協助我方參與 IEC 架構下的國際產品驗證制度。

4. 是否與 ECCB 重新簽定 MOU

我方表示，目前我國推動 IECQ 制度與美方相關機構簽訂的 4 個 MOU 均是以 CTECCB 或檢測機構的名義簽訂，如需簽訂新的 MOU，由 CTECCB 直接洽簽即可。美方回應表示，以資料來看，現有舊的合約仍舊有效，尚無需重新簽訂。惟鑑於目前 IECQ 制度在國家監督機構(NAI)部分已修正為驗證機構(CB)，且原美國國家標準機構(NSO) EIA 亦已改組，ECCB 將在會議之後，成立工作計畫，檢視現有合約是否須修正以符合新的 IECQ 架構。

三、CBAC 會議

出席人員：Mr. Wang J. Y. (CEPREI)/(CABC Chairman), Mr. Chris Yau (SGS) (CABC Vice Chairman), Mr. Adam Wu (Intertek), Mr. K. S. Lee (KTL), Ms. Dandan Zhang(CEPREI), Mr. Howard Brewer(BSI), Mr. David Smith(MC Chairman), Mr. Chris Agius(IECQ CO), Mr. Alex Chen (TUV Rheinland), Mr. Stan Salot (ECCB), Mr. Wynn Bowman(SC01), Mr. Michel Bernon (LCIE), Dr. Dreger(VDE), Ms. Wu Zheng Ping(CESI), Mr. Al Engler(DNV), Mr. Randy Dougherty (ANAB), Mr. Peter Holtmann(RABQSA), Mr. Joe Chapman(ECCB), Ms. Julia Kocs(BQPM), Mr. Lloyd Condra(ECCB), Mr. Liu Zhi Wei(CNCA), Mr. Li Sheng (CEPREI), Mr. Steve Allan(IECQ), Ms. Melinda Steinberg(IECQ), Mr. Cai Jian(CEPREI)、經濟部標準檢驗局陳局長介山、王副組長石城、CTECCB 鄭主委富雄、李執行秘書書和。

會議內容：

1. 會議議程確認：會議議程經與會各稽核機構(Certification Body, CB)代表確認並增加兩項議題：
 - IECQ 重稽核計畫。
 - 如何使用 CECC 標誌。
2. 執行 CB 重稽核，稽核報告確認
 - 法國 LCIE 稽核報告被大會承認並繼續被接受為法國之合格 CB。
 - CABC/115/R 重稽核稽核報告。
 - CABC/116/Inf 更新 NSSA 與 SSA。
 - 德國 VDE 稽核報告被大會承認並繼續被接受為德國之合格 CB。
 - CABC/117/R 重稽核稽核報告。
 - CABC/118/Inf 更新 NSSA。
 - 中國 CEPREI 稽核報告被大會承認並繼續被接受為中國之合格 CB。
 - CABC/119/R 重稽核稽核報告。
 - CABC/120/Inf 更新 NSSA。
3. 檢討各國之 NSSA 及各稽核機構之 SSA。
 - CABC/103/Inf— US NSSA。
 - CABC/104/Inf— ABSQE SSA。
 - CABC/105/Inf— ITS SSA。
 - CABC/106/Inf— NSAI SSA。

CABC/107/Inf—TUV Nord SSA。

CABC/108/Inf—SGS SSA。

CABC/109/Inf—TUV SUD SSA。

CABC/110/Inf—DNV SSA。

CABC/111/Inf—Lloyds SSA。

CABC/112/Inf—UL SSA。

CABC/113/Inf—TUV Rheinland SSA。

—大會同意在 CB 的 SSA 中不作細節的描述，如工作區域範圍、認可簽名等，在美國 NAI 轄下 CB 之 SSA 應重新送秘書處交 CABC 審查。

—會員國確認在 NSSA/SSA 中保留認可簽名，但不需包括無法獲得之參考文件。

4. CB 之年度報告。

5. 大會要求所有 CB 提供書面報告，至少需包括以下資訊：

- ◆ 廠商登錄狀況。
- ◆ 目前所提供服務之項目。
- ◆ 可能新的商機。
- ◆ 自上次會議後的宣廣活動。
- ◆ 未來的宣廣計畫。
- ◆ 其他與 CABC 相關的事件。
- ◆ IECQ OD 101 /4.10.1.1 節規定之事件。

秘書處正草擬一份報告模式交所有 CB 以為製作年度 CABC 報告之依據。

6. IECQ 程序規章與文件架構的審議

為了容易取得所需文件，會員國同意 CEPREI 的提議，明白顯示程序規章的位置及其作業文件。

7. IECQ 訓練

IECQ 認可之符合 IEC 61340-5-1 之合格稽核員訓練計畫(CABC/114/CD)。

由 CABC 副主席 Mr. Chris Yau 所提供之 3 天的 HSPM 訓練課程及 HSPM 更新課程已於昨天完成。Mr. Yau 認為這個課程值得繼續舉辦。基於此，會員國認為於 2011 年值得將目前 IECQ 正在進行之技術性的活動包括在內，如 WG 6。

8. 其他議題。

9. 會員國討論如何使用 CECC 標誌，因與位於歐州之 CB 有關且該標誌仍持續在使用之中，有必要要求於 MC 會議中納入討論。

四、MC 會議

出席人員：Mr. Wang J. Y. (CEPREI)/(CABC Chairman), Mr. Chris Yau (SGS) (CABC Vice Chairman), Mr. Adam Wu (Intertek), Mr. K. S. Lee (KTL), Ms. Dandan Zhang(CEPREI), Mr. Howard Brewer(BSI), Mr. David Smith(MC Chairman), Mr. Chris Agius(IECQ CO), Mr. Alex Chen (TUV Rheinland), Mr. Stan Salot (ECCB), Mr. Wynn Bowman(SC01), Mr. Michel Bernon (LCIE), Dr. Dreger(VDE), Ms. Wu Zheng Ping(CESI), Mr. Al Engler(DNV), Mr. Randy Dougherity (ANAB), Mr. Peter Holtmann(RABQSA), Mr. Joe Chapman(ECCB), Ms. Julia Kocs(BQPM), Mr. Lloyd Condra(ECCB), Mr. Liu Zhi Wei(CNCA), Mr. Li Sheng (CEPREI), Mr. Steve Allan(IECQ), Ms. Melinda Steinberg(IECQ), Mr. Cai Jian(CEPREI)、經濟部標準檢驗局陳局長介山、王副組長石城、CTECCB 鄭主委富雄、李執行秘書書和。

會議內容：

1. 會員國確認上次第七屆會議記錄(IECQ MC/184/DL)。

2. 會員國認可會議議程，另增加兩點議程：

—IECQ 申訴委員會。

—CECC 標誌。

3. 會員狀況

大會告知印度退出 IECQ 組織，並鼓勵參加西雅圖 2010 年 IEC 年度會議之 IECQ 會員國遊說非 IECQ 會員國之專家參加 IECQ 組織。

4. IECQ 網站更新

—會員國感謝秘書處所製作之 2009 年報告，咸認為是對會員國很有價值之資訊。

—自上次會議後，IECQ 網站做了大幅的更新，產業將受益於在 IECQ 網站上以製造廠商/國家搜索 IECQ 證書。目前 IEC 網站亦已更新，IECQ 總部已被告知，以同樣的方式更新 IECQ 網站。

—活動訊息之文章刊登在 IEC e-tech 之中。主席鼓勵所有 CB 將最新之活動資訊放在網站上。

5. IEC CAB 事務

—因 CAB 主席 Mr. Fujisawa 缺席，IECQ 主席 Mr. David Smith 代 Mr. Fujisawa 報告 CAB 會議中之決議(CAB 826/DL, CAB/864A/DL)。會員國感謝 Dr. Fujisawa 稱 IEC 組織有能力達成 2011 年的總計畫。

6. IECQ 秘書處執行秘書

認同自 Mr. Chris Agius 擔任 IECQ 執行秘書以來所作的努力，會員國同意根據 IECQ 01 基本規章，繼續向 CAB 提名他擔任第二任之 IECQ 執行秘書。

7. IECQ 計畫資訊更新

會員國同意以下之文件架構：

—IECQ 01 IECQ Scheme Basic Rule(基本規章)。

—IECQ 02 CB Requirements (CB 要求)。

—IECQ 03 IECQ Rules of Procedure (程序規章)

■ IECQ 03-1 IECQ General Requirements(一般要求)

會員國接受 MC/185B/CA 為新的 IECQ 03-1(程序規章)。

為所有認證計畫之一般要求。

■ IECQ 03-2 Approved Processes (認可作業)

會員國接受 MC/196/CD 為新的 IECQ 03-2(程序規章)。

為組織認證計畫之要求。

■ IECQ 03-3 Component Certification

會員國接受 MC/197/CA 為新的 IECQ 03-3(程序規章)。

為零件、原材料及組裝之認證計畫之要求。

■ IECQ 03-4ECMP Scheme

會員國接受 MC/186B/CA 與 MC/198/CD 為新的 IECQ 03-4(程序規章)。

為 ECMP 認證計畫之要求。

會員國接受 IECQ MC/204/CD 為新的作業文件 OD-704—IECQ ECMP 監

督稽核文件。

■ IECQ 03-5 HSPM Scheme

會員國接受 MC/187B/CD 為新的 IECQ 03-3(程序規章)。

為 HSPM 認證計畫之要求。

■ IECQ 03-6 ITL Scheme

會員國接受 MC/199/CD 為新的 IECQ 03-6(程序規章)。

為 ITL 認證計畫之要求。

■ IECQ 04 Training Body Requirements(訓練機構要求)

8. 一會員國同意依據 IEC/IAF 之 MOU 制定 IECQ 組織與認證登錄機構之間的作業，以確保同行稽核及保密協定註明於文件中。

一在美國登錄之稽核機構(CB)針對 5 年之 IECQ 重稽核計畫，要求根據 OD101 被 IECQ 稽核小組稽核。IECQ 稽核小組包括一位 ANAB 稽核員。

9. IECQ 訓練

一 經 RABQSA 取得 IECQ 訓練機構及稽核員資格，包括 IECQ HSPM 訓練

■RABQSA Mr. Peter Holtmann 介紹 RABQSA 之訓練規劃。

■CABC 會員國同意，根據 CABC 訓練機構之經驗，IECQ 稽核員經 RABQSA 認證計畫應在自願的情況之下被執行。

一 IECQ 訓練機構要求及被 IECQ 組織認可之作業要求

會員國接受 MC/200/CD 為新的 IECQ 04-1(程序規章)。

為 IECQ 訓練機構要求及被 IECQ 組織認可之作業要求。

一 執行 IECQ HSPM 訓練之標準作業程序

會員國接受 MC/201/CD 為新的 IECQ 04-5 (程序規章)。

為執行 IECQ HSPM 訓練之標準作業程序。

一 最新之 IECQ 訓練資訊：ESD 訓練計畫

會員國接受敘述於 MC/205/CD 文件中之 ESD 訓練計畫為訓練 ESD 稽核員的其中一種方式，在 IECQ 秘書處安排之下審查訓練課程及材料並更新 ESD 現有版本文件之後，會員國同意接受 ESD 訓練計畫。

10. 宣廣及市場開發

一 會員國接受由 SC 01 主席 Mr. Wynn Bowman 所提之報告。

一 大會感謝 VDE 邀請 IECQ 與 VDE 在 2010 年之 Electronica 展覽中分攤展覽攤位。

11. CABC 報告

會員國接受由 CABC 主席 Mr. Wan Juyong 所提之 CABC 報告。

12. 工作小組報告

會員國接受由 WG5 召集人 Mr. Chris Yau 所提之工作報告並接受其建議：

一 REACH 之要求納入新版 QC080000 之中。

—WG 5 工作計畫草案。

—增加會員

會員國接受由 WG4 召集人 Mr. Lloyd Condra 所提之工作報告。

會員國接受由 WG8 召集人 Mr. Joseph Cheng(鄭主任委員富雄)所提之工作報告。

13. 財務及秘書處報告

—大會接受 2009 年稽核賬目 IECQ MC/202/CD。

—大會認可 2011 年 IECQ 預算 IECQ MC/192D。

—工作小組財務規劃草案

■會員國同意附加費用草案(MC/188/CD)，IECQ 秘書處將以正式信函通知所有 CB。2010 年 7 月 1 日正式生效。

■會員國同意有關 10000CHF 之現有賬目再交財務工作小組繼續討論。

■大會接受財務工作小組所製作之新版 OD 11，在其 4 月 12 日之會議中所修改之 IECQ 訓練機構費用。

14. 其他事項。

15. —US NAI 介紹 HSF 標誌，由 US NAI Ms. Julia Kocs 負責說明。

16. —大會指定申訴委員會(Board of Appeal)委員：

Dr. Gerhard Dreger(VDE), Mr. Wynn Bowman(ECCB), Dr. Wan Juyong (CEPREI), Mr. Ki-seuk Lee (KTL)。

後補委員：

Mr. Michel Brenon (LCIE), Mr. Joe Chapman(ECCB), Mr. Chris Yau (SGS), Mr. Howard Brewer(BSI)。

主席：Mr. David Smith

秘書：Mr. Chris Agius

—CECC 標誌：會員國同意在作任何決定之前，需對 CECC 標誌之使用者及 CB 進行調查。

17. 下次會議時間、地點

—大會同意下次會議時間在 2011 年 4 月 4 日至 8 日，地點在日內瓦或新加坡舉行。

—大會感謝韓國考慮主辦 2012 年 IECQ 年會。

肆、綜合結論與建議

一、綜合結論

1. 有關 IECQ 制度推動部分，本次年會確立 WG8 汽車電子認證三階段認證計畫草案：系統認證-ISO TS16949，生產線製程認證-製程認證草案，產品認可-JEDEC 等客戶標準；另 WG5 IECQ QC080000 改版，ErP、REACH 相關內容將於 QC080000 改版時列入考慮。
2. CAG 會議主席 Mr. David Smith 特別邀請我國 CTECCB 鄭主任委員富雄（同時為電機電子工業同業公會副理事長）專題演講，介紹我國電機電子工業同業公會 (TEEMA) 組織架構、成員及推廣 IECQ 制度現狀及未來的展望，讓與會人員對我國電機電子產業的蓬勃發展與成就印象深刻。
3. 與美國 ECCB/ECCC 閉門會議，討論我國未來推動 IECQ 制度的規畫，獲致以下結論：
 - 美國 ECCB/ECCC 持續支持我國 CTECCB 開發新的認證計畫，以符合我國產業界之需要。
 - 美國 ECCB 同意邀請本局指派航太專家擔任 Subject Matter Expert(SME)，發展台灣之航太電子認證。
 - IECQ 相關技術委員會及工作小組 SC 01(市場開發)、WG 4(航太電子)、WG 6 (HSPM 產品認證)等，將請本局指派專家參與小組會議。
 - 以往美國 ECCB 與我國 CTECCB 所簽訂之各項合約繼續有效。
4. 下次會議時間在 2011 年 4 月 4 日至 8 日，地點在日內瓦或新加坡舉行。

二、心得與建議

1. 堅強的經濟發展實力為參與國際組織活動的有利後盾。

產品標準化與符合性評估活動是國際商品貿易中相當重要的一環，但我國因為國際現實因素，一直無法直接參與相關國際組織，如電機電子產品領域的國際電工委員會 IEC 及 IEC 架構下的產品符合性評估制度。我國參與國際電子零組件品質評估制度 IECQ，雖然過程有所曲折，就實質而言，已經達成相當的效益，能夠在 IECQ 制度的推動過程中積極反映我國產業界的需求，積極做出貢獻，並獲得國際間的肯定與重視。此次 IECQ 年度會議中，CAG 會議主席特別邀請我方代表

專題演講，介紹我國電機電子發展及未來的展望，在 IECQ 國際場合展現我國經濟發展的成果，同時做好國民外交。在此次行程與美國 ECCB 會議之中，ECCB 主席鼓勵我方多派遣專家參與 IECQ 組織相關工作小組之會議，當其他國家代表了解台灣對 IECQ 組織之貢獻之後，台灣參與其他組織也會比較容易。顯見堅強的經濟發展實力及積極的工作態度，為參與相關國際組織活動，爭取我國最大權益的有利後盾。

2. 積極參與 IECQ 制度以推動符合我國產業需求之認證計畫

鑑於電子零組件及產品在汽車中使用之比例愈來愈高，汽車電子產業為我國現階段積極推動發展之產業項目。在此次會議中規劃汽車電子認證之工作小組(WG 8)雖沒有提出具體的認證計畫，但亦提出系統、製程及產品之三階段認證計畫之概念，如何落實為文件化之認證標準及實際認證作業，需要繼續與國內廠商、汽車業者作深入的討論，更需專家的參與才能定案。積極參與 IECQ 制度，可以發揮我國產業創新研發的優勢，透過認證標準初期發展階段的實際參與，可以最大程度進行適合我國產業發展需求的規畫，提升我國相關產業的國際競爭力及市場商機。

伍、活動照片

IECQ CABC 會議



IECQ MC Meeting



本局及 CTECCB 與美國 ECCBECCC 閉門會議



大會晚宴時本局陳局長、CTECCB 鄭主委與主席夫婦合影



陸、附件

1. 附件 1：IECQ 秘書長邀請函.....p.20
2. 附件 2：本局與 ECCB/ECCC 會議簡報.....p.21
3. 附件 3：與 ECCB/ECCC 會議記錄.....p.24



**INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL
COMMISSION QUALITY ASSESSMENT
SYSTEM FOR ELECTRONIC
COMPONENTS (IECQ)**

The Bureau of Standards, Metrology and
Inspection
Ministry of Economic Affairs
No 4, ChiNan Road, Section 1,
Taipei 10051, Taiwan, Republic of China

2010-01-21

Dr Jay-San Chen, Director General

Subject: **Invitation to the IECQ 2010 Annual Meetings in USA**

Dear Sir,

In recognition of the significant levels of IECQ activity in your region, e.g. IECQ HSPM Certification, I would like to extend an invitation for you to attend the April 2010 series of IECQ meetings, on behalf of the IECQ Chairman Mr. David W Smith, to see first hand the updated operations of the IECQ System.

As you may be aware the IECQ HSPM Scheme (Hazardous Substance Process Management) as a means of addressing the RoHS and other Regulations concerning Hazardous Substances, continues to gain support from industry along with the ECMP (Electronic Component Management Plan) Scheme for compliance to IEC TS

62239 and now and more recently inclusion of the IEC 61340-5-1, *Electrostatics Part 5-1: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena – General requirements* now being included in the IECQ Process Approvals Scheme.

Details concerning registration along with Hotel can be found at:

http://www.iecq.org/meetings/2010/IECQ_2010_USA.html

Should you require any assistance with the registration process please contact Ms Melinda Steinberg our Business Coordinator, located at the IEC Central Office.

We do hope that you will be able to accept this invitation which is also open to a further colleague of yours if you wish.

Yours sincerely,

Chris Agius

IECQ Executive Secretary

Copy David W Smith – IECQ Chairman

IECQ Secretariat,

Head Office, rue de Varembe, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland

Telephone: +41 22 919 02 15 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: melinda.steinberg@iecq.org Web www.iecq.org

Sydney Office Level 7 Standards Australia Building, 286 Sussex Street, Sydney NSW 2001

Telephone: +61 2 8206 6940, Telefax: +61 2 8206 6272 E-mail: chris.agius@iecq.org



What BSMI/Taiwan is doing to encourage local industry to use the IECQ HSPM and other IECQ Schemes

- Promote IECQ System on the BSMI website.
- Keep providing subsidy to the factories for encouraging them to apply IECQ System.
- Study the possibility to simplify relevant testing and factory inspection requirements for inspection schemes regulated by the BSMI.
- Encourage cooperation between Taiwan Accreditation Foundation (TAF) and IECQ.

How can the ECC Corporation do to support BSMI / CTECCB

- Create new approval programs, such as HSPM PA, HSPM REACH, ErP, CARBON Footprint, Automotive Approval Program, etc., to meet the Taiwan industries' needs.
- Create marketing demands for IECQ certificates.
- Help to upgrade CTECCB participation in the IECQ.
- Extend Taiwan's participation in other international conformity assessment activities, such as IECCE CB Scheme.



New MOA between the US-NAI and BSMI to replace the one that is currently in place between US-NAI/USNC and ETC.

1. National Authorized Institution Agreement:
 - Signed and effective since May 1, 1985 by the Chairman of ECCB and CTECCB.
 2. National Standard Organization Agreement:
 - Signed and effective since May 1, 1985 by the Vice President of NSO (EIA) and the Chairman of CTECCB.
 3. National Supervising Inspectorate Agreement:
 - Signed and effective since June 7, 1991 by the Manager of NSI(UL) and the Chairman of CTECCB.
 4. National Supervising Inspectorate Agreement:
 - Signed and effective since May 1, 1986 by the Secretary of NSI(UL) and the President of ETC.
- New MOA, if necessary, should be signed by ECCB and CTECCB.

April 13, 2010

Minutes of meeting of BSMI, CTECCB, and ECC Corporation

Attendance:

Dr. Jay-San Chen Director General BSMI
Mr. Shyr-cherng Wang Deputy Director 3rd Division BSMI
Mr. Joseph Cheng Vice President – TEEMA & Chairman CTECCB
Mr. Joe Lee Executive Secretary CTECCB
Mr. Stan Salot President ECCC
Mr. Joe Chapman Secretary/Treasurer ECCC
Mr. Jack Isken Founder and past Chairman of ECCC
Mr. Wynn Bowman – Chairman Consumer Users Advisory Group ECCC
Mr. Lloyd Condra – Chairman ECCC

Purpose: BSMI IECQ related plans for CTECCB and how the ECC Corporation and BSMI/CTECCB can mutually support one another.

Mr. Condra welcomed visitors from BSMI, TEEMA, and CTECCB and thanked them for coming to the IECQ Management Meetings and for bringing forward an excellent presentation on the transition of the Chinese Taipei Electronics Components Certification Board from the Industrial Development Bureau of the Ministry of Economic Affairs to the Bureau of Standards, Metrology, and Inspection.

Dr. Chen expressed his appreciation to ECCC for arranging this meeting and noted that the effective implementation in IECQ Schemes will increase the benefit and create prosperity among IECQ members. The BSMI will fully support CTECCB and promote IECQ program in Taiwan.

Mr. Wang then briefed the group on the progress and accomplishments of moving the CTECCB organization from the IDB to BSMI. Following the office move earlier the actual conduct of the business has been successfully transitioned and CTECCB is continuing their active support of IECQ activities in Taiwan.

Critical to ongoing support of the IECQ in Taiwan is the full operations of CTECCB being supported and maintained including promotion IECQ programs, maintaining subsidy for factories desiring to apply to the IECQ system, attending meetings, trade shows, and seminars and visiting the factories. All of these operations are being supported.

It is very encouraging to know that Dr. Chen is Chairman of the Taiwan Accreditation Foundation (TAF) and this can only help to support cooperation between TAF and IECQ.

ECC Corporation will continue to support and seek new approval programs to help meet Taiwan industries needs – IECQ Automobile Qualification Approval, HSPM, ErP, REACH, HSPM PA, etc

ECC Corporation will expect BSMI support for CTECCB in 2010 and beyond in these areas:

- Seek to create a ‘page’ on the BSMI website for CTECCB and IECQ activities
- Insure the subsidy is maintained to attract new companies to IECQ

- Insure attendance by CTECCB at each semi-annual ECC Corporation meeting each year
- Seek to attract and assign appropriate Subject Matter Expert from BSMI to support CTECCB

ECCB will support CTECCB to extend participation in IECQ working groups and invite experts from BSMI to join in such working groups.

Respectfully submitted,



Joe V. Chapman
Secretary/Treasurer